



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技（中國）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：0818）

根據上市規則第13.13及第13.15條之 有關向一家企業提供之墊款披露

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.13及第13.15條（「上市規則」）而刊發，以披露高陽科技（中國）有限公司（「本公司」）連同其附屬公司，（「本集團」）向一家企業提供最少一次有關超過百份比率8%之有關墊款之詳情。

再且，除上述之交易外，本公司之董事會（「董事會」）已知悉最近本公司的股份（「股份」）價格上升，茲聲明本公司並不知悉導致此上升之任何原因。董事會再謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

本公佈乃本公司，為遵照上市規則第13.13及第13.15條而刊發，根據有關規定，當本集團向一家企業提供任何有關超過百份比率8%之墊款，即產生披露責任。

於二零零五年七月十一日，本公司之已發行股本為333,054,030股。根據於緊接二零零五年七月十一日前五個營業日於香港聯交所之平均收市價為每股股份0.538港元計算，本公司之總市值為179,183,068港元（「總市值」）。

根據本集團於二零零五年七月十一日之最近管理賬目，本集團已向銀聯商務有限公司（「銀聯」）提供合共墊款約人民幣19,600,000元（約18,300,000港元）（「墊款」），該墊款於二零零五年七月十一日超過有關百分比率之8%，佔總市值約10.21%。

向銀聯提供之墊款乃本集團與銀聯就供應電子轉賬售點終端機而於日常業務過程中產生之應收賬款。就董事會所知及所信，並須作出一切合理查詢後確認，銀聯及其最終實益擁有人為獨立於本集團及本公司之關連人士（定義見上市規則）以外之第三方。該等應收賬款乃無抵押及不計利息，償還年期為三至六個月。

再且，除上述之交易外，董事會已知悉最近本公司的股份價格上升，茲聲明本公司並不知悉導致此上升之任何原因。董事會再謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

於本公佈日期，董事會成員包括八名執行董事分別為張玉峰、渠萬春、羅韶宇、徐文生、李文晉、陳耀光、徐昌軍及周健；一名非執行董事為劉揚聲以及三名獨立非執行董事譚振輝、許思濤及梁偉民。

承董事會命
執行董事
徐昌軍

香港，二零零五年七月十二日

* 僅供識別